

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
Tel: 044-435-5111 (大代表)
http://www.necel.co.jp/

株主メモ

- 決算期 毎年3月31日
- 定時株主総会 決算期の翌日から起算して3ヵ月以内
- 基準日 毎年3月31日
- 利益配当金受領株主確定日 毎年3月31日
- 中間配当金受領株主確定日 毎年9月30日
- 1単元の株式数 100株
- 名義書換代理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社 証券代行部
[郵便物送付先] 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部
[電話照会先] ● 住所変更等用紙のご請求 ☎ 0120-175-417
● 名義書換等その他のご照会 ☎ 0120-176-417
同 取 次 所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店
- 公告掲載新聞名 日本経済新聞
- 上場証券取引所 東京証券取引所

株主の皆様へ

NECエレクトロニクス通信

2006年3月期 中間期事業報告書



2005年4月1日～
2005年9月30日

INDEX

- 株主の皆様へ…… 1
- トピックス…… 2
- 連結業績の概況…… 3
- 連結財務諸表…… 5
- 会社の概況…… 9

株主の皆様へ



株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、10月26日開催の取締役会におきまして、私、中島俊雄が社長に選任され、11月1日に就任いたしました。決意を新たに、全力を挙げてその任にあたる所存でございますので、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

当中間期（2005年4月1日から2005年9月30日まで）の事業概況等につきましてご報告申し上げます。

当中間期の半導体市場は、パソコン向けや海外の携帯電話端末向け半導体の需要が好調であった一方、DVDレコーダーやデジタルカメラなどのデジタル家電製品向けや国内の携帯電話端末向け半導体などの需要は低迷しました。また、様々な製品に用いられるマイクロコントローラやディスクリット製品も世界的に需要が低迷し、製品毎に好不調の差が激しい事業環境となりました。

このような事業環境の中、当社の当中間期の売上高は、3,129億円と前年同期に比べ639億円（17.0%）の減少となりました。これは、携帯電話端末向け、サーバおよびワークステーション向け半導体や、ディスクリット、光・マイクロ波半導体の売上高が大幅に減少したことによるものです。

連結営業損益は、121億円の損失と前年同期に比べ428億円の大幅な減益となりました。これは、実稼働率の改善などの生産性改善や費用効率化などの施策を実施したものの、売上高の減少に伴う利益減を補うことができなかったことによるものです。連結税引前損益は137億円の損失で、前年同期に比べ428億円の減益、連結当期純損益は79億円の損失で、前年同期に比べ258億円の減益となりました。

そのため、誠に遺憾ながら中間配当の実施を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様のご期待に添えず、たいへん不本意な業績をご報告申し上げますこととなり、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今後、全世界での積極的な受注の拡大、特に汎用マイクロコントローラやディスクリット製品などの収益性の高い製品群の製品力・販売網の強化に加えて、当社グループ内での人員の最適な再配置による設計力の強化、外部委託を削減し内製化を進めることによる経費削減などの諸施策を講じることにより、1日も早く業績を改善させていく所存です。

株主の皆様からの信頼回復に向け、全社一丸となり邁進する所存でございますので、何卒ご理解を賜り、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 中島俊雄

トピックス

戦略

半導体ソリューションプラットフォーム「platformOVIA」を発表

近年、電子機器の多機能化、高性能化が進む中で、ソフトウェアの開発量が急速に増大しています。

当社は、携帯電話、デジタル家電製品、車載情報システムの3分野においてお客様である電子機器メーカーの製品開発を効率化するため、半導体ソリューションプラットフォーム「platformOVIA（プラットフォームオーヴィア）」を構築しました。

プラットフォームオーヴィアは、分野ごとに最適化されたシステムLSI、システムLSIの性能を最大限に引き出す基本ソフトウェア、パートナー企業との連携で整備するミドルウェアから構成されるプラットフォームで、ソフトウェアのインターフェースを標準化して提供することにより、各分野に共通するソフトウェアの相互利用が可能となり、ソフトウェアの開発量を大幅に削減することが可能となります。

当社は、プラットフォームオーヴィアを市場に広く普及させていくことにより、システムLSIビジネスの拡大を目指していきます。



発表記者会見（2005年6月28日）の様子

新製品

次期DVDレコーダー用LSI

当社は、次期DVDレコーダー向けシステムLSIとして、デジタルハイビジョン放送の受信機能とDVDレコーダーの機能を1チップ上に集積し、業界で初めてデジタル・アナログ放送の3番組同時録画ができる高機能タイプの「EMMA（エマ）2RH」と、記録型DVDドライブ駆動機能を搭載した普及タイプの「EMMA2R-FE」の2品種を製品化しました。

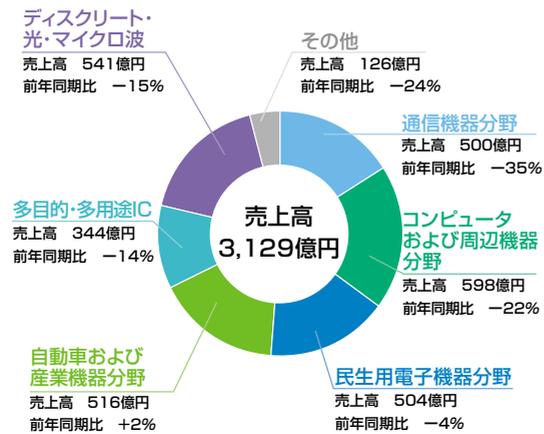
いずれのLSIも、従来必要であった複数の機能を1チップ上に集積しているため、DVDレコーダーを構築する際の部品点数の削減、基板面積の小型化などが実現でき、DVDレコーダーのコストを低減することが可能となります。



次期DVDレコーダー向けシステムLSI

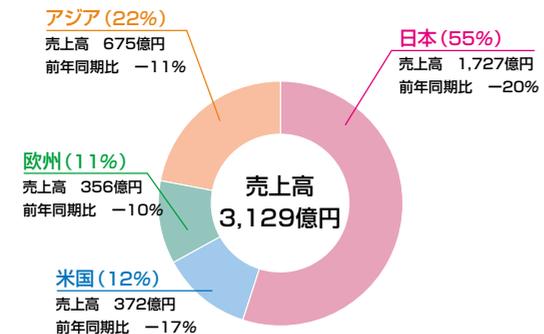
連結業績の概況

●製品分野別売上高



携帯電話端末、サーバ・ワークステーション向け半導体の売上が減少
 携帯電話端末、サーバ・ワークステーション向け半導体、ディスクリート、光・マイクロ波半導体などの売上が減少したことにより、当中間期の売上高は前年同期比17%の減少となりました。

●所在地別売上高



日本を中心に売上が減少
 当中間期は、国内で携帯電話端末向け半導体の売上が大きく減少するなど、各地域で売上が減少しました。

(注) 本事業報告書に記載されているすべての連結財務情報は、米国会計基準に準拠しています。

●製品分野別の概況

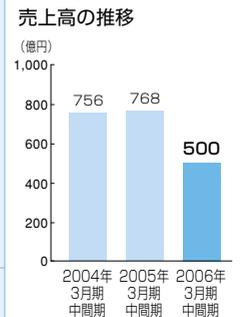
通信機器分野



ルータや携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体、携帯電話端末向け半導体

携帯電話端末向け半導体の売上が大幅に減少

当中間期は、主として高性能携帯電話端末市場が飽和状態に近くなっていることによる国内市場の伸び悩みにより、携帯電話端末向け半導体の売上が前年同期と比べて大幅に減少しました。



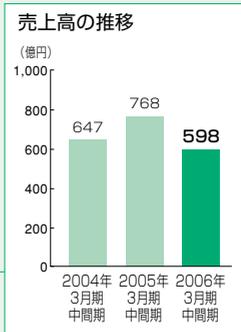
コンピュータおよび周辺機器分野



サーバおよびワークステーション向け半導体、パソコン周辺機器向け半導体

サーバおよびワークステーション向け半導体の売上が大幅に減少

当中間期は、サーバおよびワークステーション向け半導体の売上が、海外の特定顧客向けの売上が減少したことにより、前年同期と比べて大幅に減少しました。



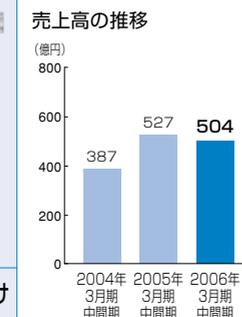
民生用電子機器分野



デジタル家電製品向け半導体、ゲーム機向け半導体

デジタル家電製品向け、ゲーム機向け半導体は堅調

当中間期は、デジタル家電製品向け、ゲーム機向け半導体の売上は前年同期と比べほぼ横ばいとなりました。しかし、VTR(ビデオテープレコーダー)などの従来型家電製品向け半導体の売上が減少したことにより、全体として売上減となりました。



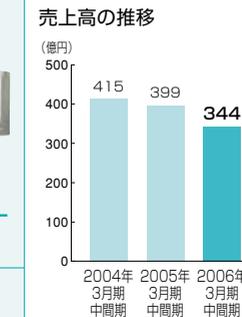
多目的・多用途IC



汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途メモリなど

ゲートアレイの売上が減少

当中間期は、汎用マイクロコントローラの売上は前年同期と比べほぼ横ばいとなりましたが、ゲートアレイの売上が国内市場を中心とした需要減などにより減少しました。



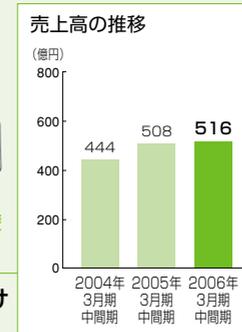
自動車および産業機器分野



自動車向け半導体、計測器や医療機器などの産業機器向け半導体

自動車向け、産業機器向け半導体の売上が増加

当中間期は、自動車向け半導体、産業機器向け半導体ともに堅調に推移し、それぞれ前年同期と比べて売上増となりました。



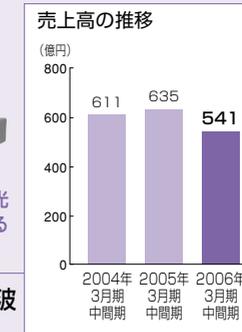
ディスクリート・光・マイクロ波



トランジスタなどの個別半導体、光通信や携帯電話端末などに使われる光・マイクロ波半導体

ディスクリート、光・マイクロ波半導体の売上が減少

当中間期は、主としてアジアにおける電子機器の生産調整の影響を受け、ディスクリートおよび光・マイクロ波半導体の売上はそれぞれ前年同期と比べて減少しました。



連結財務諸表

●連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当中間期末 2005年9月30日現在	前期末 2005年3月31日現在
資産の部		
流動資産	424,220	418,641
現金および現金同等物	201,651	225,691
受取手形および売掛金	113,269	100,287
たな卸資産	72,171	67,718
その他の流動資産	37,129	24,945
固定資産	375,525	395,581
投資等	12,348	10,673
有形固定資産	324,684	343,491
その他の資産	38,493	41,417
資産合計	799,745	814,222

現金および現金同等物

240 億円減

主として2005年3月期下半期に実施した300ミリウエハラインへの設備投資に関わる設備代金の支払いなどにより、前期末と比べ240億円の減少となりました。



有形固定資産

188 億円減

既存設備の減価償却の進行や、所有設備の一部を売却しリースに切り替えたことなどにより、前期末と比べ188億円の減少となりました。



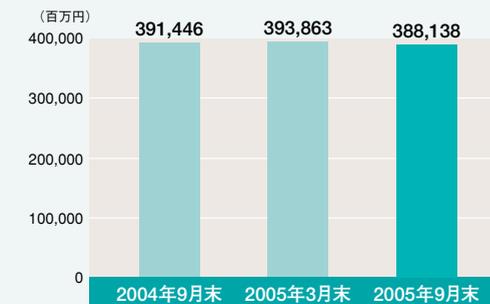
(単位：百万円)

科目	当中間期末 2005年9月30日現在	前期末 2005年3月31日現在
負債・資本の部		
流動負債	196,190	202,726
短期借入金	15,044	15,534
支払手形および買掛金	117,548	123,096
その他の流動負債	63,598	64,096
固定負債	211,529	213,689
社債および長期借入金	136,880	137,435
未払退職および年金費用	74,424	76,254
その他の固定負債	225	-
少数株主持分	3,888	3,944
資本	388,138	393,863
資本金	85,955	85,955
資本剰余金	274,916	276,687
利益剰余金	32,945	40,829
その他の包括損益累計額	△ 5,678	△ 9,608
負債および資本合計	799,745	814,222

株主資本

57 億円減

当期純損失を79億円計上したことで利益剰余金が減少したことなどにより、前期末と比べ57億円の減少となりました。



有利子負債残高

10 億円減

長期借入金を返済したことなどにより、前期末に比べ10億円の減少となりました。



連結財務諸表

●連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 2005年4月 1日～ 2005年9月30日	前中間期 2004年4月 1日～ 2004年9月30日
● 売上高	312,944	376,827
● 売上原価	229,334	251,921
● 研究開発費	54,807	52,763
● 販売費および一般管理費	40,952	41,479
● 営業損益	△ 12,149	30,664
● 営業外収益	894	2,013
● 受取利息および配当金	423	209
● 雑収益	471	1,804
● 営業外費用	2,405	3,587
● 支払利息	361	394
● 雑損失	2,044	3,193
● 税引前損益	△ 13,660	29,090
● 法人税等	△ 5,532	11,345
● 少数株主損益(控除)	△ 244	△ 154
● 当期純損益	△ 7,884	17,899

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

売上高の推移

前年同期比
639
億円減

携帯電話端末向け、サーバおよびワークステーション向け半導体や、ディスクリット、光・マイクロ波半導体などの売上高が大幅に減少したことにより、前年同期と比べ639億円の減少となりました。



営業損益の推移

前年同期比
428
億円減

実稼働率の改善などの生産性改善や費用効率化などの施策を実施したものの、売上高の減少に伴う利益減を補うことができなかったことにより、前年同期と比べ428億円の減益となりました。



当期純損益・1株当たり当期純損益の推移



(注) 希薄化後1株当たり当期純損益は、転換社債型新株予約権付社債の発行により資金調達を行った前年同期と比べると、705億円の収入減となりました。

●連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	当中間期 2005年4月 1日～ 2005年9月30日	前中間期 2004年4月 1日～ 2004年9月30日
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー		
● 当期純損益	△ 7,884	17,899
● 営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整		
● 減価償却費	42,200	45,149
● 受取手形および売掛金の(増加)減少額	△ 10,260	2,613
● たな卸資産の(増加)減少額	△ 3,672	1,673
● 支払手形および買掛金の増加(減少)額	2,892	698
● その他	△ 8,624	10,199
● 計	14,652	78,231
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
● 有形固定資産売却額	29,215	2,274
● 有形固定資産購入額	△ 60,772	△ 76,708
● 有価証券売却額	345	-
● 貸付金の(増加)減少額	-	4,443
● その他	△ 2,961	△ 1,340
● 計	△ 34,173	△ 71,331
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	△ 19,521	6,900
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
● 社債および借入金の増加(減少)額	△ 2,305	67,483
● 配当金支払額	△ 1,234	△ 2,469
● その他	△ 1,974	△ 1
● 計	△ 5,513	65,013
● 為替変動の現金および現金同等物への影響額	994	724
● 現金および現金同等物純増加(減少)額	△ 24,040	72,637
● 現金および現金同等物期首残高	225,691	165,460
● 現金および現金同等物期末残高	201,651	238,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

147 億円の収入

(前年同期比636億円の収入減)

当期純損益が258億円減少したことや受取手形および売掛金が129億円増加したことなどにより、前年同期と比べ636億円の収入減となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

342 億円の支出

(前年同期比372億円の支出減)

300ミリウエハラインへの設備投資などの有形固定資産購入額が減少したことや、所有設備の一部を売却しリースに切り替えたことなどにより、前年同期と比べ372億円の支出減となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

55 億円の支出

(前年同期比705億円の収入減)

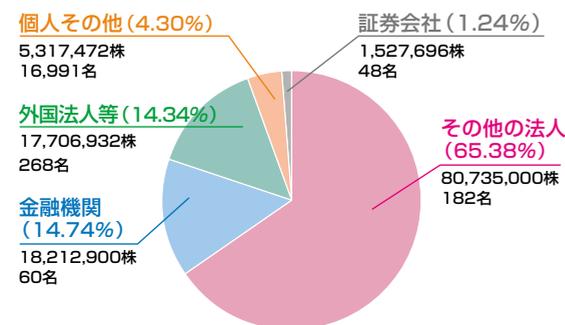
転換社債型新株予約権付社債の発行により資金調達を行った前年同期と比べると、705億円の収入減となりました。

会社の概況

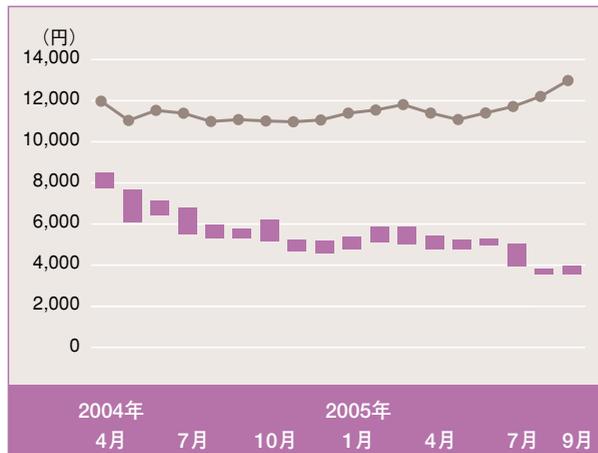
株式の状況 (2005年9月30日現在)

- 発行する株式の総数 400,000,000株
- 発行済株式総数 123,500,000株
- 株主数 17,549名

●所有者別状況



●株価の推移 ■ 当社株価(高値/安値) ● 日経平均株価



(注)日経平均株価は終値の月次平均を表示しております。

●大株主(上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本電気株式会社	80,300	65.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口)	6,200	5.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,545	2.87
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,764	2.24
ドイチェ バンク トラスト カンパニー アメリカズ	1,486	1.20
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド	1,444	1.17
ユービーエス エイジー ロンドン アジア エクイティーズ	1,364	1.11
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	1,121	0.91
ロイヤルトラスト コープ オブ カナダ クライアント アカウント	722	0.59
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103	639	0.52

(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口)の持株数6,200千株(持株比率5.02%)は、日本電気株式会社が保有する当社株式の一部を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権行使の指図権は日本電気株式会社が留保しております。

●IRホームページ

個人投資家の方に当社への理解をより深めていただくため、専用のページを開設しましたので、ぜひご覧ください。

<http://www.necel.com/ja/ir/>

●お問い合わせ先

NECエレクトロニクス株式会社
コーポレートコミュニケーション部 IR担当
Tel: 044-435-1664 e-mail: ir@necel.com

会社の概要 (2005年9月30日現在)

- 商号 NECエレクトロニクス株式会社
- 創立 2002年11月1日
- 資本金 860億円
- 事業内容 システムLSIを中心とした各種半導体に関する研究、開発、製造、販売およびサービス
- 従業員数(連結) 24,134名
- 本社 〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
Tel: 044-435-5111 (大代表)

●主な関係会社

■国内生産会社

NEC山形
NEC福井
NEC関西
NEC山口
NEC九州
NECセミコンパッケージ・ソリューションズ
NECファブサーブ

■国内販売・設計会社

NECマイクロシステム
NECデバイスポート

■半導体事業会社

NEC化合物デバイス

■海外生産会社

NECエレクトロニクス・アメリカ*1
NECセミコンダクターズ・アイルランド
NECセミコンダクターズ・シンガポール
NECセミコンダクターズ・マレーシア
NECセミコンダクターズ・インドネシア
首钢日電電子有限公司*2

■海外販売・設計会社

NECエレクトロニクス・ヨーロッパ
NECエレクトロニクス台湾
NECエレクトロニクス・シンガポール
NECエレクトロニクス中国*3
NECエレクトロニクス香港
NECコンパウンドセミコンダクター
デバイス香港*4
NECエレクトロニクス上海

*1: NECエレクトロニクス・アメリカは生産および販売を担当しています。

*2: 首钢日電電子有限公司の販売部門は、NECエレクトロニクス中国*3へ統合されました。

*3: NECエレクトロニクス中国(正式社名: 日電電子(中国)有限公司)は、北京NEC集成回路設計有限公司から社名変更しました。

*4: NEC化合物デバイスの販売会社です。

●取締役、監査役および執行役員(2005年11月1日現在)

代表取締役社長 中島 俊雄
取締役執行役員常務 後藤 秀人
取締役執行役員常務 山口 純史
取締役 鈴木 俊一
取締役相談役 戸坂 馨
監査役 田上 紀夫(常勤)
鈴木 啓士(常勤)
柴田 保幸
松本 滋夫
執行役員 稲田 義一
佐藤 奨
佐藤 博
細谷 豊造

Q&A

株主の皆様のご質問にお答えいたします。

| 配当の予定について教えてください

当期の配当につきましては、前期に比べ連結・単独業績とも売上高が大幅に減少し、当期純損益が赤字となることが見込まれることから、中間配当については見送ることとし、期末配当につきましても見送らせていただく予定です。

当社としましては、業績改善に向けた諸施策を講じることにより、1日も早く業績を改善させ、復配できるような努めてまいります。